



- Mate2022 第28回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム
—半導体・実装のテクノロジー・ドライバー～スケールリングからヘテロジニアス・インテグレーションへ～ 参加者募集
- WEB掲載の溶接学会論文集39巻(2021年度)の印刷物の購入について
- 2022年度春季全国大会講演概要の頒布について
- IIW 2022年次大会(東京大会)国際会議への投稿について

Mate2022 第28回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム —半導体・実装のテクノロジー・ドライバー～スケールリングからヘテロジニアス・インテグレーションへ～ 参加者募集

日時：2022年2月1日(火)～14日(月)

開催方式：オンライン(オンデマンド+ライブQ&A)

主催：(一社)スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会

(一社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会

共催：(一社)エレクトロニクス実装学会

(公社)化学工学会 エレクトロニクス部会

(一社)レーザ加工学会

協賛：応用物理学会、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会

<開催趣旨>

日本のエレクトロニクス産業は、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の成長を牽引してきました。さらに今後、IoTやAIを活用した未来社会を実現していくためには、生産技術の科学的探求をベースとしつつ、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

【参加費】*税込み、論文集PDFダウンロード付

	2022/1/14 まで	1/15 以降
主催団体個人会員	16,000円	18,000円
主催団体シニア会員	8,000円	10,000円
大学・国公立研究機関	16,000円	18,000円
口頭発表者・座長	16,000円	18,000円
主催団体維持・賛助会員	20,000円	22,000円
共催団体会員	20,000円	22,000円
協賛団体会員	25,000円	27,000円
一般	30,000円	32,000円
学生	7,000円	9,000円

■論文集(冊子)：5,000円

*希望者は参加申込み時にお申込み下さい。

【シンポジウム参加申込方法】

下記シンポジウムURLより、2022年1月14日(金)までに参加登録を行って下さい(1月15日以降も同リンク先より受付致しますが、視聴用ID・パスワードの発行にお時間を頂く場合があります)。

<https://confit.atlas.jp/mate2022>

○参加費は銀行振込にてお支払い下さい。

振込先銀行：三井住友銀行 千里中央支店

口座番号：普通0978673

口座名：Mate組織委員会 [メイトソシキイインカイ]

振込期限：2022年2月28日(月)

【問合せ、申込先】 Mate 2022 事務局

TEL：06-6879-7568 FAX：06-6879-7568

E-mail：mate@sps-mste.jp

シンポジウムURL：

<https://confit.atlas.jp/mate2022>

【予定プログラム(セッション名と発表件数)】

●プレナリーセッション

テーマ 「半導体・実装のテクノロジー・ドライバー
～スケールリングからヘテロジニアス・インテグレーションへ～」

1. 半導体・デジタル産業戦略について

荻野 洋平氏 経済産業省 商務情報政策局
情報産業課 デバイス・半導体戦略室

2. チップレット化時代における半導体実装技術の新潮流

折井 靖光氏 長瀬産業株式会社 NVC室

●依頼講演+一般論文+速報論文発表

接合信頼性

ナノ・マイクロマテリアル

有機/無機接合(1)

有機/無機接合(2)

ソルダリング

接合プロセス・接合特性(1)

接合プロセス・接合特性(2)

パワーデバイス(1)

パワーデバイス(2)

MEMS・医療センサ

実装基板

システム化・解析・シミュレーション(1)

システム化・解析・シミュレーション(2)

めっき

樹脂材料

次世代パッケージ

プリンタブルエレクトロニクス(1)

プリンタブルエレクトロニクス(2)

(依頼講演4件+一般論文発表49件+速報論文発表30件
合計83件)

WEB掲載の溶接学会論文集39巻(2021年度)の印刷物の購入について

溶接学会論文集は、2007年1月より印刷物での発刊に代わってホームページ上にてWEB版として発刊されております。

印刷物にて一年分を纏めたものを購入される方は、下記により、2022年3月31日までにお申込み下さいますようお願いいたします。

溶接学会論文集39巻(2021年度)

【価格】 15,800円/冊(税込・送料別)

【申込先】 「お名前(会社名)」「送付先住所」「冊数」
をご明記の上、FAXにてお申込み下さい。

日本印刷出版株式会社 TEL: 06-6441-0075
FAX: 06-6443-5815

2022年度春季全国大会講演概要の頒布について

2015年度春季全国大会より講演概要はデジタル化され、配布方法はホームページからのダウンロードのみとなり、従来のような大会前、大会当日の販売は廃止いたしました。

ただし、印刷版の全国大会講演概要は大会終了後、希望者へ別売にて提供させていただきます。

購入を希望される方は下記要領にてお申し込みくださいますようお願いいたします。

2022年度春季全国大会講演概要

価格: 12,000円(税・送料込)

発送時期: 2022年6月下旬

【申込方法】

「書籍名」「ご連絡先」「お名前」「冊数」をご明記の上、FAXにてお申し込みください。折り返し、請求書をお送りいたします。

一般社団法人溶接学会 全国大会運営委員会 宛

F A X : 03-5825-4331

申込締切: 2022年5月9日(月)

入金締切: 2022年5月31日(火)

なお、入金締切日までにご納入がない場合ご注文はキャンセルとさせていただきます。

IIW 2022年次大会(東京大会)国際会議への投稿について

IIW(国際溶接学会)の2022年次大会(東京大会)が2022年7月17日(日)~22日(金)に開催されます。

IIW年次大会・国際会議は18の常置の専門委員会と溶接・接合国際会議(International Conference on Welding and Joining)で構成されています。

日本開催のIIW年次大会を大いに盛り上げるため国際会議に論文の投稿をお願いします。

11月中旬には国際会議のCALL FOR PAPERSのサイトが公開さ

れAbstract Submissionも受け入れ可能となっております。
詳細は下記URLからお願いします。

IIW 2022年次大会ホームページ

<https://www.iiw2022.com/index.html>

国際会議(International Conference on Welding and Joining)

<https://www.iiw2022.com/cfp.html>

2020・2021年度編集委員

(委員長) 伊藤 和博

(委員) 井上 裕滋, 猪瀬幸太郎, 大橋 良司, 大畑 充, 荻野 陽輔, 河西 龍, 笠野 和輝, 門井 浩太,
門田 圭二, 児嶋 一浩, 小山 真司, 佐藤 裕, 島貫 広志, 銭谷 哲, 田川 哲哉, 谷口 公一,
中谷 光良, 朴 勝煥, 福本 信次, 藤田 善宏, 富士本博紀, 松下 宗生, 三上 欣希, 三瓶 和久,
三橋 克広, 峰村 晋司, 宮坂 史和, 村上 寛企, 山上 雅史, 山本 啓

溶接学会誌 第91巻 第1号

2022年1月1日 印刷

2022年1月5日 発行

編集兼発行者 小 熊 輝 男
東京都千代田区神田佐久間町4丁目20番地

印刷者 日本印刷出版株式会社
大阪市福島区玉川4丁目7-13

発行所 一般社団法人 溶 接 学 会

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4丁目20番地

電話 03(5825)4073

FAX 03(5825)4331

振替口座 00180-7-143434 番

ホームページ <https://jweld.jp/>